

招 标 公 告

无锡夏普电子元器件有限公司（以下简称我司），欲对现有一批设备进行公开招标贩卖，诚邀有意向的公司参与本次招标。

1. 项目名称：设备贩卖
2. 贩卖对象清单：详见附件一
3. 招标公告截止时间：2023 年 5 月 24 日
4. 具体竞价招标将通过我司招标系统统一实施

有意向的投标公司（人）可联络我司：

具体负责人：裴先生

联络电话：18961823513

附件一

序号	设备名称	数量（台）
1	COG 压着机	1
2	COG 压着机	1
3	COG 压着机	1
4	COG 压着机	1
5	COG 压着机	1
6	COG 压着机	1
7	COG 压着机	1
8	COG 压着机	1
9	T-FLEX 压着装置	1
10	T-FLEX 压着装置	1
11	T-FLEX 压着装置	1
12	T-FLEX 压着装置	1
13	T-FLEX 压着装置	1
14	T-FLEX 压着装置	1
15	CG 贴合机	1

2023 年 5 月 16 日